证券代码：002916　　证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-27

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议　□现场参观 □媒体采访　□业绩说明会　□新闻发布会 □路演活动　√其他　（　上市公司网上集体接待日　）
活动参与人员（排名不分先后）	投资者网上提问
上市公司接待人员	董事长、总经理：杨智勤；副总经理、董事会秘书：张丽君；总会计师：楼志勇
时间	2026 年 11 月 26 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
形式	线上交流
投资者关系活动主要内容介绍	**交流主要内容：** 公司就投资者在本次网上集体接待日中提出的问题进行了回复： **Q1、本次定增项目最新推进节奏，预计什么时候投产并贡献营收？** 尊敬的投资者，您好。公司本次募投项目为无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，建设期为 1 年，当前项目正按计划推进。项目投产及产能实际爬坡节奏受客户认证、订单落地等多重因素影响。当前公司算力相关业务需求持续向好，相关产品订单较为饱满，公司将持续加强内部能力建设，加快重点客户项目导入，力争缩短产能爬坡周期，支撑业务发展。感谢您的关注。 **Q2、封装基板业务盈利拐点大概何时到来，后续提升高端产品毛利率的核心举措是什么？** 尊敬的投资者，您好。业务盈利水平受产品结构、良率水平、产能利用率等多重因素影响。2026 年上半年，封装基板业务毛利率为 31.35%，同比增加 16.20 个百分点。公司将聚

	焦战略目标客户开发与目标产品导入，加快 FC-BGA 产品能力建设，继续夯实运营能力，做好供应链保障工作。感谢您的关注。 **Q3、高速 PCB 及封装基板当前在手订单、明年算力订单能见度如何，海外头部算力客户定点拓展有没有新进展？** 尊敬的投资者，您好。当前公司算力相关业务需求持续向好，AI 服务器、高速交换机、光模块及应用处理器类载板等产品订单饱满。整体产能利用率处于高位运行状态。感谢您的关注。 **Q4、您好 贵司本次定增募投的 IC 载板项目，预计产能爬坡节奏、良率目标是多少？** 尊敬的投资者，您好。公司本次向特定对象发行股票募投项目为无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，产品主要面向 AI 服务器、交换机用高速高密高多层 PCB，建设期为 1 年。产能实际爬坡节奏受客户认证、产品结构、市场环境等因素影响。目前公司算力相关业务需求向好、订单饱满，公司将持续夯实内部运营能力，加快推进重点客户项目落地，并通过持续优化工艺、强化生产管控，不断提升产品良率水平。感谢您的关注。 **Q5、您好 杨董事长 目前行业库存压力下，贵司存货周转后续改善预期如何？** 尊敬的投资者，您好。在下游需求旺盛、业务规模扩张的情况下，公司存货同比增加，主要因部分原材料供应紧张，为保障订单交付，公司进行合理备货；同时由于产品结构变化，在产品流程步数增加，导致在产品金额有所增长。公司将持续跟踪上游供应节奏，动态优化备货策略，同步提升产品制造运营效率，做好存货精细化管理。感谢您的关注。 **Q6、贵司 30 层及以上 FC-BGA 封装基板已进入研发打样阶段，未来在加快高端产品量产方面，是否考虑与具备成熟高密度微孔加工及精密电镀技术的企业开展深度产业协同？** 尊敬的投资者，您好。公司 FC-BGA 类封装基板已具备 26 层及以下产品批量生产能力，30 层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司始终坚持与产业链各方深度协同，重视产业链共赢发展。感谢您的关注。
关于本次活动是否涉及	交流过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

应披露重大信息的说明	
附件清单	无